

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

紫光国芯微电子股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：20250819

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☒ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	具体名单详见附件，排名不分先后
时间	2025 年 8 月 19 日（星期二）下午 15:00-16:00
地点	线下+线上会议 线下会议：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座 16 层 线上会议：进门财经平台
上市公司接待人员姓名	董事、总裁：李天池 副总裁：岳超 财务总监：杨秋平 副总裁：翟应斌 董事会秘书：罗永君
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司董事会秘书介绍公司 2025 年半年度整体情况（概要） 2025年上半年，公司延续聚焦主业的战略方向，在特种集成电路、智能安全芯片、石英晶体频率器件三大核心业务领域持续发力。面对持续变化的市场环境，公司稳步推进各项业务开展，深化技术创新，落实市值管理举措。公司整体经营保持稳定，为实现年度发展目标奠定坚实基础。 （一）经营情况 1. 经营业绩方面 2025年上半年，公司实现营业收入30.47亿元，较上年同期增长6.07%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.53亿元，较上年同期增长4.39%。截至2025年6月30日，公司总资产176.96亿元，较上年度末增长2.17%；归属于上市公司股东的净资产128.78亿元，较上年度末增长3.90%。 2025年第二季度，公司营业收入环比增长97%、同比增长17%；归属于上

	市公司股东的扣除非经常性损益的净利润环比增长451%、同比增长39%；经营活动产生的现金流量净额环比增长420%。 2. 科技研发方面 公司保持研发投入强度，核心技术和关键产品持续迭代，取得发明专利26项和实用新型专利6项。在特种集成电路领域，公司处于行业领先地位。目前已经形成的几大系列产品，均得到广泛应用。围绕FPGA、SOC、SoPC、DSP等核心主控芯片外，还拥有丰富外围配套产品，能够与核心主控芯片配套成完整的系统解决方案向用户推广，缩短用户设计与验证周期，获市场广泛认可。在智能安全芯片领域，掌握安全算法、安全攻防、高可靠等多项核心技术及专利，搭建设计、测试、质量保障和工艺外协等技术平台；产品通过银联芯片安全认证、国密二级认证、国际SOGIS CC EAL6+、ISCCCE AL4+/EAL6+、GSMA SAS-UP等国内外权威认证，以及AEC-Q100车规认证、ISO26262 ASILD认证、ISO/SAE 21434认证、ASPICE CL2认证，安全性方面达国际顶尖水准，广泛应用于金融支付、移动通信、身份识别、物联网、汽车电子等多个领域。在石英晶体频率元器件领域，公司在国内实现应用Q-MEMS光刻技术的高端晶片自主化生产，具备微型片式音叉谐振器、高基频晶体谐振器、高基频晶体振荡器大规模生产能力；产品向微型化、片式化、高频化、高精度、高稳定性方向发展，品类齐全，总产能与产销量位居中国大陆行业前列，成为众多国内知名企业国产化替代主力供应商。 （二）业务亮点 1. 特种集成电路业务 2025年上半年，公司聚焦未来特种集成电路市场需求方向，进行深入调研，完成了多项新产品的研制规划；期间优化研发组织架构以提升研发团队效率、缩短研制周期；自建封装线顺利投产，产品质量达到行业先进水平，同时提升了供应链自主可控能力与质量保证能力；通过持续提升测试能力和产线的自动化水平，进一步增强供货保障能力、缩短产品交付周期。 FPGA及系统级芯片产品在行业市场持续领先，用户范围进一步扩大，新一代高性能产品已批量交货。特种存储器产品继续保持国内技术最先进、系列最全优势，在行业内处于核心配套地位；网络与接口领域，新推出的交换机芯片批量交货且用户范围拓宽，同时完成新一代交换机芯片项目研制规划，保持技术领先。RF-SOC、数字信号处理器DSP等专业系统集成芯片整体推进情况良好，应用范围进一步扩大；高端的AI⁺视觉感知、中高端MCU等领域产品研制进展顺利，将进入公司未来专业主控芯片产品系列。在模拟产品领域，公司高性能射频时钟、多通道射频采样收发器、低功耗以太网PHY、低噪声电源模组、系统监控电路等产品技术指标国内领先，得到了广泛应用，订单持续增加。 2. 智能安全芯片业务 2025年上半年，公司智能安全芯片业务在产品技术与市场拓展上获新突破；同时保持高强度研发投入，推进技术创新与新技术预研，深化布局多元业务，持续深耕安全芯片领域，全面发力汽车电子业务。
--	---

	(1) 公司持续深耕电信SIM卡市场，保持在全球SIM卡芯片市场的领先地位；eSIM产品导入多家头部手机厂商，批量发货；搭载全球首款开放式软硬件架构安全芯片E450R的银行卡试点首发,为金融IC卡全面国产化提供了可复用的技术范式。 (2) 汽车安全芯片解决方案品类更加完善，在多家头部Tier1和主机厂量产落地，年出货量数百万颗，护航智能汽车转型升级。域控芯片新产品导入多家头部Tier1和主机厂。 3. 石英晶体频率器件业务 2025年上半年，伴随着消费类电子市场的持续改善以及网络通信、智能汽车等领域的快速发展推动，石英晶体频率器件需求持续上升，业务呈现稳健发展态势；公司以市场需求为导向，紧抓国产替代机遇，深耕网络通信、车用电子、工业控制等重点市场，同时积极布局空天信息、人工智能、低空经济等新兴市场，以提升重点领域市场占比与新兴市场渗透率。 (1) 公司持续加强小型化、高频化、高精度产品及产业化关键共性技术研发，SMD2016型高基频差分晶体振荡器、SMD2520型高基频温度补偿差分晶体振荡器研发成功，市场竞争力进一步提升。 (2) 不断扩展高基频产品、高稳定产品以及振荡器产品品类，有效匹配客户多元化需求；热敏晶体谐振器（TSX）产品、音叉晶体谐振器（TF）产品市场规模持续拓展；多款车规级产品可靠性满足AEC-Q200/100要求；超微型石英晶体谐振器生产基地项目建设进展顺利。 （三）市值管理 2025年上半年，公司积极贯彻落实“质量回报双提升”行动方案，不断提升上市公司质量与投资价值，增强投资者回报和获得感。 1. 强化信息披露，传递公司价值 公司一方面持续强化信息披露管理，优化信息披露有效性，构建以投资者需求为导向的信息披露体系。另一方面深化投资者关系管理服务：及时接听投资者热线电话保障咨询渠道畅通、高效回应投资者关切，2025年上半年共回复深交所“互动易”平台问题181条；积极组织参加各类投资者交流活动，包括2024年度业绩说明会、2024年度业绩交流会等，其中业绩说明会集中回复问题63个；通过多维度多形式的沟通，向投资者传递公司价值与经营理念，增进其对公司的理解与认同。 2. 重视投资者回报，共享发展成果 公司于2025年4月21日召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十三次会议，于5月13日召开2024年度股东会，审议通过《2024年度利润分配预案》。根据前述利润分配预案，公司实施了2024年年度权益分派，向投资者现金分红总额共计1.77亿元。 3. 响应投资者呼声，及时回购股份 公司于2025年4月21日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。根据前述回购公司股份方案，公司于2025年6月27日至2025年7月11日通过股份回购专用证券账
--	---

户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,089,916股，成交总金额为1.99亿元（不含交易费用）。公司以实际行动切实维护广大投资者利益，稳定及提升公司价值。

二、问答交流环节

（一）特种集成电路业务方面

1. 2025年上半年，公司子公司深圳市国微电子有限公司收入和净利润同比增长比较明显，其中数字芯片和模拟芯片的占比较去年是否发生一些变化，哪些品类可能看到更高的增长态势？

答：公司特种集成电路业务中模拟芯片占比约为40%至50%，增长速度约在18%至20%。2025年，在特种集成电路业务方面，从订单角度来讲，整体偏乐观；但目前难以预测2026年及2027年的订单情况。公司将继续丰富产品品类，抢占下游的市场，不断巩固和提升市场的占有率。

2. 2025年上半年，交换机芯片产品业务范围扩大情况具体是怎样的？

答：在交换机芯片业务上，订单确实有所增长。公司不仅核心主控芯片产品订单有所提升，配套产品订单也实现了同步增长。在特种集成电路领域，公司对研发组织架构进行了优化，各大类别的主要核心产品都有新一代产品的规划，新一代交换机芯片只是其中的一部分。未来公司将持续加强对特种集成电路领域的投入，期望在新一代的技术上保持领先地位。

3. 公司的交换机芯片是否应用涉及到AI数据中心的应用场景？如果当下没有涉及，下一代交换机芯片的研究项目规划是否会涉及？

答：公司的交换机芯片暂不涉及到AI数据中心的应用场景。公司也在关注这一市场方向。

4. 高端AI⁺视觉感知芯片现在应用场景如何？

答：目前高端AI⁺视觉感知芯片主要应用于特种集成电路领域的目标识别和跟踪；该产品比较偏前期，需要结合下游需求进行落地。

5. 特种集成电路订单年初至今态势如何？同比变化是什么状态？是否可以展望一下？

答：在特种集成电路业务方面，2025年第一季度订单最多；每个月订单均有波动，但同比较去年均有所增长的；年初至今订单的同比增加，对公司今年的业绩有一定的保障；未来2年的业绩需要跟踪公司后续的订单情况，有一定的不确定性。

6. 公司特种集成电路业务第一季度（Q1）和第二季度（Q2）营业收入大概是多少？从订单确认收入周期看，第三季度（Q3）的营业收入是不是大于Q2营业收入？

答：公司特种集成电路业务Q1营业收入为4.10亿元，Q2营业收入为10.59亿元，较Q1环比增加158%；Q3的营业收入难以确定，需视订单、生产安排及交货情况来定。

7. 公司今年在宇航业务有什么新的进展？未来有什么推进？

答：在宇航业务方面，公司推出了耐辐照的产品。目前该业务发展良好，是公司业绩的新增量之一。

	8. 公司特种集成电路各大产品系列的营业收入占比情况如何？ 答：在特种集成电路领域，逻辑芯片、存储芯片、总线驱动接口、电源等收入占比接近95%，其他产品收入占比约5%，各大产品系列的增速基本持平，未来可能会维持这个结构。公司以FPGA、SOC、SoPC、DSP等核心主控芯片为主，搭配丰富的外围配套产品，形成完整的系统解决方案向用户推广。 9. 在特种集成电路领域，公司FPGA、新一代FPGA、RF-SOC芯片等产品的业务布局和市占率情况如何？未来是如何进行推广？ 答：公司FPGA芯片产品上半年出货量和市场占有率维持在一个高位；新一代FPGA及RF-SOC芯片等产品市场拓展比较顺利，备货比较充足，可以满足2025年的市场需求。公司也在统筹各方面资源，筹划新一代FPGA及RF-SOC芯片等产品的未来市场推广工作，以实现可持续高质量发展。 10. 特种集成电路领域，目前看毛利率存在较大压力，未来毛利率如何？ 答：2025年上半年，特种集成电路领域的毛利率是下降的，但下降比较平缓。针对毛利率的下降情况，公司采取了相应措施，第一，基于公司特种集成电路业务产品结构全面特性，深度挖掘各类产品潜力，提高产品竞争力；第二，通过降低采购成本、优化过程控制、加强供应链管理、提升质量管控水平等多项措施，有效降低了生产成本。 11. 公司第二季度（Q2）营业收入比预期表现好，第一季度（Q1）特种集成电路订单有多少在第二季度（Q2）确认收入？ 答：由于今年Q1公司特种集成电路订单同比增长，部分订单要求的交货期较短，公司加快了交付进度。Q1接的订单一般不会对Q1确认收入，基本上是Q1发货的订单，会在Q2确认收入。 12. 能否通过以某季度特种集成电路收入乘以4的方式测算其全年的收入情况？ 答：不能直接通过某季度特种集成电路收入乘以4的方式测算其全年的收入情况。因为具体数值仍需视订单量及收入确认等实际情况而定。 （二）智能安全芯片业务方面 1. 关于公司汽车安全芯片、MCU芯片及eSIM产品在下游客户拓展情况、销售规模及未来增长空间的情况，请问目前的进展如何？ 答：汽车数字钥匙等安全芯片市场整体运行平稳，未出现明显市场波动，公司相关业务保持稳定推进态势。汽车MCU芯片产品导入下游车厂的进程顺利，受益于国产化替代的行业趋势，多数车厂已明确表达使用需求，但当前汽车行业竞争格局激烈，车厂对国产MCU芯片的替换需求有一个过程，因此尽管导入环节进展良好，产品实现大规模量产上量仍需一定周期。eSIM产品市场需求热度较高，但该领域受政策监管影响显著。目前与eSIM相关的核心政策尚未正式明确，行业内企业均在积极做好技术、产能等前期准备工作；待后续政策正式落地后，行业及公司相关业务有望迎来阶段性发展机遇。 2. eSIM芯片产品不考虑政策发展的节奏，我们目前与下游客户合作关系
--	--

如何？主要客户的市场份额占比情况怎样？如果未来政策出现积极变化，我们能获得怎样的收益？

答：公司目前与下游客户合作关系整体保持稳定，eSIM芯片产品布局多年，已基本完成或处于持续推进状态。eSIM芯片产品在全球范围内已具备批量出货能力，但受国内eSIM相关政策尚未开放的影响，国内市场暂未正式启动；一方面，国内手机厂商的eSIM机型出货量相对有限；另一方面，现有海外销售的机型多采用海外芯片方案，客观上限制了国产芯片在国内市场的应用场景。若eSIM政策迎来开放契机，国内手机市场将成为关键增长点，带动eSIM芯片的市场需求，有助于提升产品出货量与市场份额。目前，公司eSIM芯片产品已完成技术准备，国内eSIM进入测试验证阶段，后续商业化落地与市场突破，将主要依托政策层面的进一步推动。

3. 咱们车载的MCU芯片目前的总体销售规模大概在什么体量上？

答：目前，公司车载MCU芯片的整体销售规模尚处于较低水平，业务开展以向客户提供样品、推进产品测试验证及市场导入工作为主，规模化量产销售暂未全面启动。

4. 公司是否已经在数字货币或稳定币相关的硬件载体，如超级SIM卡芯片或eSIM卡芯片的支付定位方面进行产品布局？未来在支付领域的定位和规划是怎样的？

答：公司在数字货币和稳定币相关硬件载体方面已有技术布局，目前，公司现有芯片产品的技术能力，已可覆盖此类应用场景的核心需求。此前，公司在数字人民币钱包领域已取得一定市场成果，不过该应用场景尚未广泛普及。同时，在现有客户合作中，已有客户基于公司芯片产品开发出相关支付应用的实际案例，验证了公司技术方案的可行性。未来发展的关键在于政策导向、市场需求以及用户使用习惯。公司已在技术和产品层面做好准备，但具体应用的推广还需依赖市场发展和产业链各方的合作。

5. 我们产品的技术相较于eSIM芯片技术有哪些区别？

答：公司具备eSIM芯片的技术，并已经完成相应产品的开发和量产。

6. 目前国内除了我们之外，还有哪些企业在涉及eSIM芯片？

答：目前国内eSIM芯片领域，除我司外，核心参与者仍以SIM卡芯片领域的传统头部企业为主。从市场属性来看，eSIM芯片国外市场属于成熟市场，国内市场尚未放开。因此，行业内多家企业长期对该领域保持关注，并围绕技术研发、产品适配、产能储备等方面开展前期准备工作。

7. 目前公司SIM卡芯片市场份额占比60%或更高，那么类比eSIM芯片，公司在国内市场是否也会取得相应的份额？

答：将eSIM芯片国内市场份额提升至与当前SIM卡芯片相当的水平，是公司长期规划中的重要目标，但实现这一目标面临较多不确定性，需结合市场环境、竞争格局及自身发展节奏综合判断。公司SIM卡业务能占据高份额，是长期市场竞争的结果；而eSIM芯片目前主要应用在海外市场，海外芯片占据一定优势，公司市场份额提升还需要长期积累以及国内政策的支持。

8. 车载的eSIM芯片与手机端的芯片在价格上相比，是否车载芯片的价格

明显更高？价格的差大概在什么数量级？

答：从当前市场看，车载eSIM芯片的单价确实略高于手机端eSIM芯片。相较于手机端eSIM芯片，车载eSIM芯片整体市场使用规模远低于手机端。近年来受汽车行业市场竞争加剧的影响，车规级产品的定价策略逐步调整，目前与手机端等消费级产品的价格差距已收窄。未来二者价格差异是否会出现震荡波动或进一步收敛，目前暂无法准确判断。

9. SIM卡芯片产品毛利达到40%或更高的毛利率水平，那么eSIM芯片的毛利率是否会保持或更高的水平？

答：公司SIM卡芯片产品此前呈现的高毛利率，核心源于前两年行业“缺芯”现象及特定行业周期的阶段性驱动，这一盈利表现具有明显的时期特殊性。关于eSIM芯片产品的毛利率，结合公司当前技术储备、国内eSIM芯片市场竞争格局及业务规划综合预判，其毛利率水平预计将优于SIM卡产品的毛利率，但最终毛利率水平需重点关联eSIM芯片产品相关政策的放开节奏和落地细则。

（三）其他方面

1. 公司二季度毛利率同比有一定的压力，延缓了一季度下降的趋势，目前这个利润率的压力主要是来自于产品结构的变化，还是受到降价因素的影响，以及如何展望全年的利润率情况？

答：毛利率二季度比一季度有一些好转的迹象，但总体来说，现在两大产业板块都面临着市场的竞争，价格面临下降的风险。从两年前开始，市场就面临着价格下行的风险，但公司产品毛利率是随着市场行情在缓慢下降。公司通过加强产品研发，关注高毛利产品的销售，内部加强管理，提升信息化水平等，从降本增效上进行内部挖掘。虽然外部市场环境仍处于价格下行趋势，但通过内部管理和效率提升，基本上毛利率下滑的幅度是可控的。

2. 今年不同领域产品价格相较于去年的降幅情况如何？降幅是否呈现出收窄的趋势？

答：具体降幅情况还要看终端市场的需求情况和竞争情况，公司内部特种集成电路业务也在研发高毛利产品，大的市场环境是竞争在加剧，价格在下降，公司特种集成电路业务有较长时间的积累，产品品种比较全，在面临市场价格下行的风险面前，抗风险能力比较强，如产品比较紧俏，价格自主权会大些。

3. 公司回购股份进度及后续股权激励方案思路？

答：公司于2025年4月8日接到董事长回购股份的提议，于2025年4月21日召开董事会审议通过1至2亿元的回购股份额度。公司于2025年6月27日至7月11日在较短的时间内按照上限完成了股份回购。公司是希望通过回购，加强市值管理工作，提升投资者信心。公司目前在积极推进股权激励方案，部分内容还需进一步细化。

4. 我们比较关心无锡的封测线以及目前的投产进度，因为之前很多是以外协方式生产的，如果将这部分纳入生产线，能节省多少成本？

答：无锡封装线是一条高可靠、高质量的封装线，投入规模较大。当前

	最主要的任务是将原来外协的封装产品大规模导入，满足特定需求，未来可能会承担更多任务。
附件清单(如有)	不适用
日期	2025 年 8 月 19 日

附件:参会名单

序号	机构名称
1	民生加银基金管理有限公司
2	中邮证券有限责任公司
3	长江证券股份有限公司
4	中国国际金融股份有限公司
5	上海申银万国证券研究所有限公司
6	东方证券股份有限公司
7	瑞银证券有限责任公司
8	招商证券股份有限公司
9	兴业证券股份有限公司
10	国泰海通证券股份有限公司
11	中国人寿资产管理有限公司
12	华安财保资产管理有限责任公司
13	国金证券股份有限公司
14	西部证券股份有限公司
15	方正证券股份有限公司
16	中泰国际资产管理有限公司
17	华西证券股份有限公司
18	中意资产管理有限责任公司
19	融通基金管理有限公司
20	国投证券股份有限公司
21	摩根士丹利亚洲有限公司
22	华创证券有限责任公司
23	湘财基金管理有限公司
24	兴业基金管理有限公司
25	天风证券股份有限公司上海证券自营分公司
26	光大证券股份有限公司
27	长江证券(上海)资产管理有限公司
28	长城基金管理有限公司
29	中原证券股份有限公司
30	贝莱德集团
31	长城证券股份有限公司
32	工银安盛资产管理有限公司
33	民生证券股份有限公司
34	中华联合保险集团股份有限公司
35	开源证券股份有限公司
36	百年保险资产管理有限责任公司
37	上海盘京投资管理中心(有限合伙)
38	中国人民保险集团股份有限公司
39	浦银安盛基金管理有限公司
40	泉果基金管理有限公司
41	嘉实基金管理有限公司

序号	机构名称
42	广发证券股份有限公司
43	华夏基金管理有限公司
44	广发基金管理有限公司
45	太平基金管理有限公司
46	鼎和财产保险股份有限公司
47	天治基金管理有限公司
48	汇丰前海证券有限责任公司
49	永赢基金管理有限公司
50	天弘基金管理有限公司
51	创金合信基金管理有限公司
52	汇丰晋信基金管理有限公司
53	中荷人寿保险有限公司
54	浙商证券股份有限公司
55	富国基金管理有限公司
56	上银基金管理有限公司
57	信达澳亚基金管理有限公司
58	湘财证券股份有限公司
59	中信保诚基金管理有限公司
60	国盛证券有限责任公司
61	东亚前海证券有限责任公司
62	财通证券股份有限公司
63	华福证券有限责任公司
64	汇添富基金管理股份有限公司
65	国泰君安国际控股有限公司
66	博道基金管理有限公司
67	海南劲恒私募基金管理合伙企业(有限合伙)
68	西部利得基金管理有限公司
69	山西证券股份有限公司
70	IGWT Investment 投资公司
71	摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
72	信泰人寿保险股份有限公司
73	银华基金管理股份有限公司
74	国联安基金管理有限公司
75	国信证券股份有限公司
76	金鹰基金管理有限公司
77	中国人寿保险股份有限公司
78	国融证券股份有限公司
79	诺德基金管理有限公司
80	国联民生证券股份有限公司
81	天风证券股份有限公司
82	南京证券股份有限公司
83	泓德基金管理有限公司

序号	机构名称
84	长安基金管理有限公司
85	鹏华基金管理有限公司
86	凯基证券亚洲有限公司
87	信达证券股份有限公司
88	华泰证券股份有限公司
89	工银瑞信基金管理有限公司
90	弘毅远方基金管理有限公司
91	兴证全球基金管理有限公司
92	华泰证券(上海)资产管理有限公司
93	财达证券股份有限公司
94	国元证券股份有限公司
95	中邮创业基金管理股份有限公司
96	东方财富证券股份有限公司
97	淳厚基金管理有限公司
98	圆信永丰基金管理有限公司
99	宏利基金管理有限公司
100	嘉实基金管理有限公司
101	东方阿尔法基金管理有限公司
102	南方基金管理股份有限公司
103	华泰柏瑞基金管理有限公司
104	远信资本投资管理有限公司
105	易方达基金管理有限公司
106	长盛基金管理有限公司
107	安信基金管理有限责任公司
108	中信证券股份有限公司
109	诺安基金管理有限公司
110	中汇人寿保险股份有限公司
111	中国银河证券股份有限公司
112	新华基金管理股份有限公司
113	东方基金管理股份有限公司
114	兴证全球基金管理有限公司
115	国联民生证券股份有限公司
116	申万菱信基金管理有限公司
117	申万宏源证券有限公司
118	国泰基金管理有限公司
119	国联基金管理有限公司
120	德邦证券股份有限公司
121	中金资产管理有限公司
122	华商基金管理有限公司
123	前海开源基金管理有限公司
124	中国人寿养老保险股份有限公司
125	华夏基金管理有限公司

序号	机构名称
126	建信养老金管理有限责任公司
127	大成基金管理有限公司
128	深圳进门财经科技股份有限公司